



■ VDE fordert strategische Industriepolitik für IKT und Mikroelektronik

In Europa hängen rund 200 000 Arbeitsplätze direkt und mehr als 1 000 000 indirekt von der Elektronik und Mikroelektronik ab. Basis dafür sind führende Positionen in der Automobilelektronik (circa 50 % Marktanteil), in Energieanwendungen (circa 40 % Marktanteil) und in der Industrieautomatisierung (circa 35 % Marktanteil) sowie Stärken im Elektronikentwurf für die mobile Telekommunikation und bei intelligenten Mikrosystemen. Dass Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern seine industrielle Basis bisher halten konnte, ist vor allem seinen ‚Hidden Champions‘ zu verdanken: kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit großer Innovationskraft, marktführender Stellung und hohem Exportanteil. In den nächsten Jahren werden völlig neuartige technische Systeme mit vollständig integrierten, intelligenten Funktionen auch in Bereiche vordringen, die bisher noch ohne sie auskamen. Damit kommt der Fähigkeit zur Entwicklung und Herstellung elektronischer Systeme eine Schlüsselrolle für die industrielle Produktion im 21. Jahrhundert und den weiteren wirtschaftlichen Erfolg der deutschen Unternehmen zu. Das zeigt das neue VDE-Positionspapier ‚Hidden Electronics‘.

- Studie zeigt Schlüsselrolle der ‚Hidden Electronics‘ für den Arbeitsmarkt
- KMUs im globalen Wettbewerb sind zunehmend benachteiligt
- Experten sind für mehr Engagement bei Grundlagenforschung

Das VDE-Positionspapier ‚Hidden Electronics‘ wurde von Experten der Informationstechnischen Gesellschaft im VDE sowie der VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und Feinwerktechnik erstellt. Es ist im Info-Center auf der Website kostenlos als Download erhältlich

(www.vde.com/de/InfoCenter/Studien-Reports/Seiten/Mikroelektronik-Mikrotechnik.aspx).

Weitere Informationen: www.vde.com/gmm

■ European Congress on e-Cardiology & e-Health

29.-31. Oktober 2014 in Bern

In Kooperation mit unseren Partnern des Inselspitals Bern möchte der Heinz-Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik auf diesen Kongress aufmerksam machen.

Rund um das Themenspektrum ‚Herausforderungen, Evaluation und Integration von e-Health und Telemedizin in heutigen Gesundheitssystemen‘ soll im Dialog mit Ärzten, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern und Pflegepersonal, Universitäten und Forschungsinstitutionen sowie Vertretern aus Gesundheits- und Regierungsinstitutionen, Industrie und Service-Anbietern, die gemeinsame Interaktion und Zusammenarbeit angeregt werden.

Die Schwerpunktthemen des Kongresses werden in einzelnen Sessions, Vorträgen und Industrieständen präsentiert, u. a. zu:

- Klinischen Anwendungen
- Telerehabilitation
- Aktuelle Situation und Herausforderungen der e-Cardiology und e-Health
- Telemedizin und mobile Anwendungen
- Vernetzung, gemeinsame Plattformen, Datensicherheit
- Weitere Themen...

Bitte beachten Sie den Call for Abstracts bis zum 31. Juli 2014. Weitere Informationen finden Sie hier: www.e-cardiohealth.org.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Info: Karolin Herzog M.A., Heinz Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik, Professor Bernhard Wolf, Technische Universität München, Theresienstraße 90, Gebäude N3, 80333 München, www.lme.ei.tum.de

■ Tagungsband zeigt Wege zu einem effizienten und nachhaltigen Strom-Wärme-System

Für eine erfolgreiche Energiewende müssen die Sektoren Strom und Wärme zu einem effizienten Gesamtenersystem verknüpft werden. Der Tagungsband des Forschungsverbands Erneuerbare Energien zeigt aktuelle Forschungsergebnisse für ein nachhaltiges Strom-Wärme-System auf der Basis erneuerbarer Energien.

In den bevorstehenden Phasen der Energiewende wird es darauf ankommen, die Komponenten des Energiesystems optimal aufeinander abzustimmen. Dabei werden der Strom- und der Wärmesektor viel stärker zusammenwirken müssen als bislang. Daraus resultieren komplexe konzeptionelle und technologische Herausforderungen für die Weiterentwicklung des Energiesystems. Es gilt, die Möglichkeiten für Ausgleich, Ergänzung und Umwandlung der verschiedenen Energieformen für die Optimierung des Gesamtsystems einzusetzen.

Der Forschungsverbund ‚Erneuerbare Energien‘ hat die Beziehungen zwischen den Sektoren Strom und Wärme zum Thema seiner Jahrestagung 2013 gemacht. Der jetzt vorliegende Tagungsband ‚Forschung für ein nachhaltiges Strom-Wärme-System‘ zeigt die systemischen Zusammenhänge und gegenseitigen Abhängigkeiten von Strom und Wärme und stellt technische Innovationen für das Zusammenspiel beider Bereiche vor. Der Tagungsband steht im Internet unter www.fvee.de im Bereich ‚Publikationen/Themenhefte‘ zum Download zur Verfügung und kann dort auch als gedrucktes Heft kostenfrei bestellt werden. Der Titel lautet: ‚Forschung für ein nachhaltiges Strom-Wärme-System (Themen 2013)‘. Die Mitglieder des Forschungsverbund ‚Erneuerbare Energien‘ erforschen und entwickeln Technologien für erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energiespeicherung sowie deren Integration in Energiesysteme. Der FVEE repräsentiert ungefähr 80 % der Forschungskapazität für erneuerbare Energien in Deutschland und ist das größte koordinierte Forschungsnetzwerk für erneuerbare Energien in Europa. Broschürenversand: Frau Wunschick (fvee@helmholtz-berlin.de).

■ Proceedings

Die Proceedings des diesjährigen Seminars in Dresden zum Thema ‚Volumenintegration – Stapeln, Falten, Vergraben‘, können auf CD zum Preis von € 55,-

erworben werden. Die aktuelle CD-ROM enthält neben den 2014’er Proceedings auch die mehrerer früherer Herbst- und Frühjahrsveranstaltungen. Unsere Seminare sind traditionell themenorientiert und beschäftigten sich zuvor mit zu Themen wie ‚Medizintechnik- Herausforderungen an das Packaging‘, ‚Manche mögen’s heiß – Power Electronic Packaging‘, oder ‚Ist Zuverlässigkeit noch bezahlbar?‘



Ihre Bestellungen richten Sie bitte an:

Ernst Eggelaar, c/o Microtronic GmbH,
Kleingrötzing, D-84494 Neumarkt-St. Veit,
Fax +49-8722-9620-30, ee@microtronic.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß §4 Nr.22 UStG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

■ IMAPS Deutschland – Ihre Vereinigung für Aufbau- und Verbindungstechnik

IMAPS Deutschland, Teil der ‚International Microelectronics and Packaging Society‘ (IMAPS), stellt seit 1973 in Deutschland das Forum für alle dar, die sich mit Mikroelektronik und Aufbau- und Verbindungstechnik beschäftigen. Mit mehr als 300 Mitgliedern verfolgen wir im Wesentlichen drei wichtige Ziele:

- wir verbinden Wissenschaft und Praxis
- wir sorgen für den Informationsaustausch unter unseren Mitgliedern und
- wir vertreten den Standpunkt unserer Mitglieder in internationalen Gremien.

■ Impressum

IMAPS Deutschland e.V.

1. Vorsitzender:

Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow
martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de

Schatzmeister

(bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag):
Ernst J. M. Eggelaar, ee@microtronic.de



Ausführliche Kontaktinformationen zu den Vorstandsmitgliedern finden Sie unter www.imaps.de (Vorstand)